

2019年3月25日

各位

上場会社名 株式 会 社 新 川 代 表 者 代表取締役社長執行役員 長野 高志 (コード番号6274 東証第一部) 問合せ先責任者 取締役専務執行役員

> 経 営 管 理 本 部 長 森 琢也 (電話番号 03-5937-6404)

(開示事項の経過) アピックヤマダ株式会社との共同持株会社体制への移行に伴う

会社分割に関するお知らせ

当社は、2019年2月12日付「アピックヤマダ株式会社との共同持株会社体制への移行に伴う会社分割に関するお知らせ」において、2019年7月1日を効力発生の予定日とする新設分割(以下「本会社分割」といいます。)により、アピックヤマダ株式会社(以下「アピックヤマダ」といいます。)との共同持株会社体制へ移行する旨を公表しております。

本日開催の取締役会において、本会社分割についての新設分割計画を決議いたしましたので、従前の開示において未定としていた事項について、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本会社分割は、当社、ヤマハ発動機株式会社(以下「ヤマハ発動機」といいます。)及びアピックヤマダによる事業統合(以下「本事業統合」といいます。)のための一連の取引の一環として行われるものであり、2019年4月26日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、本会社分割に関する議案の承認が得られること及び一定の条件が充足されることを効力発生の前提としております。詳細につきましては、2019年2月12日付「ヤマハ発動機株式会社、株式会社新川及びアピックヤマダ株式会社による事業統合(株式会社新川によるアピックヤマダ株式会社の完全子会社化、ヤマハ発動機株式会社による株式会社新川の子会社化及び株式会社新川の会社分割による共同持株会社体制への移行)に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、今般決定した事項については、当該事項に下線を付しております。また、本会社分割は単独新設分割 に該当しますので、開示事項・内容を一部省略して記載しております。

1. 本会社分割の目的

当社、ヤマハ発動機及びアピックヤマダの三社は、2019 年2月12日開催の各社の取締役会において、第三者割当増資を通じたヤマハ発動機による当社の子会社化、並びに、公開買付け及びその後の一連の手続を通じた当社によるアピックヤマダの完全子会社化及び当社の本会社分割による当社及びアピックヤマダの共同持株会社体制への移行を伴う三社間の本事業統合を行うことをそれぞれ決議し、統合契約書を締結いたしました。本会社分割は本事業統合のための一連の取引の一環として行われるものです。本事業統合の目的につきましては、2019 年2月12日付「ヤマハ発動機株式会社、株式会社新川及びアピックヤマダ株式会社による事業統合(株式会社新川によるアピックヤマダ株式会社の完全子会社化、ヤマハ発動機株式会社による株式会社新川の子会社化及び株式会社新川の会社分割による共同持株会社体制への移行)に関するお知らせ」の「1.本事業統合の目的」をご参照ください。

2. 本会社分割の要旨

(1) 本会社分割の日程

取	ń	締	役	숮	決	Ē	議	目	2019年2月12日
臨	時	株	主 総	会 基	基 準	日 夕	\$ 告	日	2019年2月19日
臨	時	梤	主	総	会	基	準	日	2019年3月6日
新	設 分	割言	十 画 =	書 承 認	取 締	役 会	決 議	日	2019年3月25日 <u>(本日)</u>
臨	時	梤	主	総	会	決	議	日	2019年4月26日 (予定)
新	設	分	割	効	力	発	生	日	2019年7月1日 (予定)

(2) 本会社分割の方式

当社を分割会社とし、新設する新設分割設立会社(以下「新設会社」といいます。)を承継会社とする新設分割です。

なお、当社は本会社分割の効力発生を条件として商号を<u>「ヤマハモーターロボティクスホールディン</u> グス株式会社」に変更する予定です。

(3) 本会社分割に係る割当ての内容

<u>新設会社は、</u>本会社分割に際して普通株式 <u>10,000</u> 株を発行し、そのすべてを当社に割当交付いたします。

(4) 本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりませんので、該当事項はありません。

(5) 本会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金等の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

当社が営む事業のうち、共同持株会社として必要な機能を除く一切の事業に関して有する資産、負債、契約上の地位その他の権利義務(ただし、その性質上承継が困難な権利義務等は除きます。)を<u>承継する予定です</u>。

(7) 債務履行の見込み

当社及び新設会社は、本会社分割後の資産の額が負債の額を上回ることが見込まれ、また本会社分割後に負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予見されておりません。したがって、本会社分割後も当社及び新設会社の負担すべき債務の履行の見込みは問題ないものと判断しております。

3. 本会社分割の当事会社の概要

3. 平云红刀刮切目事云红切枕安	·			
	分割会社		新設会社	
	(2018年9月30日	現在)	(2019	年7月1日設立予定)
(1) 名 称	株式会社新川(2019年7) 予定)	月1日変更	株式会社新	F)II
(2) 所 在 地	東京都武蔵村山市伊奈平二 地の1	二丁目 51番	東京都武蔵 地の1	村山市伊奈平二丁目 51番
(3) 代表者の役職・氏名	 代表取締役社長 長野 	韦志		<u>会長 長野 高志</u> 社長 石岡 <u>修</u>
(4) 事 業 内 容	半導体製造装置の開発・	製造・販売	半導体製造	装置の開発・製造・販売
(5) 資 本 金	8,360 百万円		100 百万円	
(6) 設立年月日	1959年8月6日		2019年7月	月1日(予定)
(7) 発行済株式数	20,047,500 株		10,000株	
(8) 決 算 期	3月31日(注)1.		12月31日	
大株主及び持株比率 (2) (注) 2. 3. (10) 分割会社の最近3年間の	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 5.50% GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4.98% みずほ信託銀行㈱ 退職給付信託 きらぼし銀行口 4.49% 日本トラスティ・サービス信託銀行 ㈱ (信託口) 4.05% 日本マスタートラスト信託銀行㈱ (信託口) 3.27%			100%
	株式会社新川(分割会社)(連結)			<u></u> 車結)
·	2016年3月期	2017年3	3月期	2018年3月期
連結純資産	20, 570		21, 579	21, 545
連結総資産	23, 340		25, 201	24, 959
1株当たり連結純資産(円)	1, 131. 83	1, 187. 36		1, 185. 52
連結売上高	12,662		16, 438	15, 214
連結営業利益	△1, 035		294	△620
連結経常利益	△1, 444		432	△488
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	△1, 849	243		563
1株当たり連結当期純利益(円)	△101.75	13. 37		31.00

(単位:百万円。特記しているものを除く。)

- (注) 1. 当社の本臨時株主総会での承認決議を前提に決算期を12月31日に変更する予定です。
 - 2. 持株比率は発行済株式総数(自己株式を含みます。)に対する比率を記載しております。また、小数点以下第三位を四捨五入して表示しております。
 - 3. 当社は、2018 年 9 月 30 年現在において自己株式 1,858,789 株 (9.27%) を保有しておりますが、 上記大株主からは除外しております。

〔分割又は承継する事業部門の概要〕

(1) 分割又は承継する部門の事業内容

当社が営む半導体製造装置およびその技術を応用した電子精密機器等の研究・開発・設計・製造・販売及び保守サービス

(2) 分割又は承継する部門の経営成績(2018年3月期実績)

	分割事業	当社実績 (単体)	比率
	(a)	(b)	(a ÷ b)
売上高	14, 122 百万円	14,122 百万円	100%

(3) 分割又は承継する資産、負債の項目及び帳簿価格

	資産	<u>負債</u>		
<u>項目</u>	帳簿価格	<u>項目</u>	帳簿価格	
流動資産	10,559 百万円	流動負債	<u>1,854 百万円</u>	
固定資産	459 百万円	固定負債	631 百万円	
<u>合計</u>	<u>11,017 百万円</u>	<u>合計</u>	2,485 百万円	

なお、上記に記載されている項目及び帳簿価額は 2018 年 12 月 31 日現在の金額に基づく見込み額であり、実際に分割される金額は上記と異なることがあります。

4. 本会社分割後の状況

				分割会社	新設会社
(1)	名		称	<u>ヤマハモーターロボティクスホール</u> ディングス株式会社	株式会社新川
(2)	所	在	地	東京都武蔵村山市伊奈平二丁目 51 番 地の1 (登記上の本店) なお、実質上の本社は今後決定いた します。	東京都武蔵村山市伊奈平二丁目 51 番 地の1
(3)	代表	者の役職・	氏名	代表取締役会長 加藤 敏純 代表取締役社長 石岡 修	代表取締役会長 長野 高志 代表取締役社長 石岡 修
(4)	事	業内	容	グループ経営管理事業及び資産管理 事業等	半導体製造装置の開発・製造・販売
(5)	資	本	金	13,360百万円 (注)	100 百万円
(6)	決	算	期	12月31日	12月31日

⁽注)分割会社の第三者割当増資実施による資本金増加額 5,000 百万円を反映後の予想資本金を記載しております。

5. 会計処理の概要

「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号平成25年9月13日)に基づき共通支配下の取引として会計処理する予定です。

<u>6.</u> 今後の見通し

本会社分割により事業を承継する新設会社は、当社の100%子会社であるため、本会社分割が連結業績に与える影響は軽微と見込んでおります。

以上